



**NEWS ANNOUNCEMENT**

**FOR IMMEDIATE RELEASE**

※本リリースは 2021 年 10 月 13 日に発表されたリリースを翻訳したものです

## **タワーセミコンダクター、テクニカルグローバルシンポジウム 2021 のオンライン開催を発表**

**高度なアナログ技術と製造ソリューションに基づくリーダーシップと通信、自動車、医療、AI、先端ディスプレイ、産業市場での高まるニーズに対応したテクノロジーソリューションと開発ロードマップを紹介**

**イスラエル、ミグダル ハエメク、2021 年 10 月 13 日** - 高付加価値アナログ半導体ファンドリソリューションのリーダーである**タワーセミコンダクター**(NASDAQ/TASE:TSEM)は、本日、2021 年のテクニカルグローバルシンポジウムのオンライン開催を発表しました。このイベントでは、タワーの経営陣が、現在、そして将来高まる市場ニーズに基づく最新のイノベーションと開発ロードマップを含む RF & ハイパフォーマンスアナログ、パワーマネジメント、センサなど先端のアナログテクノロジープラットフォームについての概要を紹介します。また、同社のグローバルな製造能力、ソリューション、キャパシティ増強プログラムについても紹介します。

**開催日時:**

2021 年 11 月 16 日 – USA session , 9:00am Pacific time

2021 年 11 月 17 日 – Europe/APAC session, 日本時間 5:00pm

各セッションの概要は以下の通りです

※すべて英語のみの講演となります

### **CEO Keynotes - Russell Ellwanger**

#### **Analog technology for the future of communications, automobiles, and artificial intelligence**

Dr. Marco Racanelli、上級副社長およびアナログ事業部ジェネラルマネジャー

このセッションでは、光トランシーバー、ソリッドステート LiDAR、ニューロモフィックコンピューティングの未来を可能にする、タワーの主要なシリコンフォトニクスファウンドリプラットフォーム、また、最先端の RF SOI 技術と 5G 以降をサポートする大規模な生産能力を備えた携帯機器向けの Tier-1 RF サプライヤーとしての包括的なソリューション

ンについて説明します。業界トップクラスの効率性を備えた先端のパワーBCD テクノロジーについて、自動車の電動化によって推進されるロードマップを、グリーンで持続可能な世界にフォーカスして説明します。

## **Image Sensor and Displays: state-of-the-art technologies for the industrial, medical and AR/VR fast growing markets**

Dr. Avi Strum 上級副社長およびセンサー&ディスプレイ事業部ジェネラルマネジャー

このセッションでは、産業、自動車、およびモバイル市場向けハイエンドの Time of Flight(ToF)およびグローバルシャッターアプリケーション向けのウェハースタッキング技術など、タワーの最新の CIS プラットフォームと最新の成果について説明します。また、大型ステッチセンサー技術で医療用や歯科用市場向けに設計された 300mm の先進的なソリューション開発についても紹介します。さらに、次世代 VR ヘッドセット向けの non-imaging センサソリューションやマイクロ LED、マイクロ OLED ディスプレイについても説明します。

## **Manufacturing Excellence**

**Mr. Rafi Mor、最高執行責任者**

このセッションでは、タワーの製造能力増強への取り組み、世界的な高品質の製造能力、多様性について説明します。200mm および 300mm のマルチファブおよび相互認定された生産プラットフォームにより、製造の柔軟性および最大限の活用に関する情報を提供し、生産量の保証を可能にします。また、有効性、効率性、品質に焦点を当てた質の高い製造プログラムについてもご紹介します。

TGS 2021 の詳細については[こちら](#)をご覧ください。

## **タワーセミコンダクターについて**

タワーセミコンダクター株式会社(NASDAQ:TSEM,TASE:TSEM)は、高付加価値のアナログ半導体ソリューションのファンドリリーダーで、コンシューマー、産業機械、車載用、モバイル、インフラ、医療用、航空宇宙・防衛などの成長市場で集積回路 (IC)の技術・製造プラットフォームを提供しています。タワーセミコンダクターは、長期的なパートナーシップと先端の革新的なアナログテクノロジーの提供を通じて、意義あるサステナブルインパクトを創造することに注力し、SiGe、BiCMOS、ミックスドシグナル /CMOS、RF CMOS、CMOS イメージセンサ、non-image sensor、パワーマネジメント(BCD および 700V)、MEMS など、カスタマイズが可能なプロセスプラットフォームを幅広く提供しています。また迅速かつ正確なデザインサイクルを実現する世界クラスのデザインイネーブルメントを提供し、IDM やファブレス企業向けにはプロセス移管サービスを提供しています。複数のファブを使ってサービスを提供するために、タワーセミコンダクターはイスラエルに 2 か所(150mm と 200mm)、米国に 2 か所(200mm)、TPSCo が保有する日本の 3 か所(200mm と 300mm)に生産拠点ががあります。詳細は [www.towersemi.com](http://www.towersemi.com) をご覧ください。

**Tower Semiconductor Company Contact:** Orit Shahaar | +972-74-7377440 | [oritsha@towersemi.com](mailto:oritsha@towersemi.com)

**Tower Semiconductor Investor Relations Contact:** Noit Levy | +972-4-604-7066 | [noitle@towersemi.com](mailto:noitle@towersemi.com)